

2017年1月17日

AGC 旭硝子、半導体パッケージおよびサポート用ガラス基板を開発 —幅広いニーズに対応できる材料特性・サイズ・厚みをラインナップ—

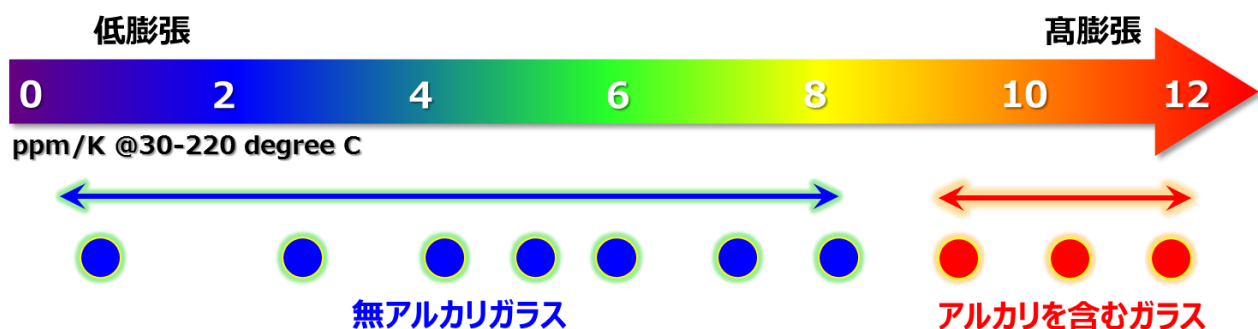
AGC旭硝子（旭硝子株式会社、本社：東京、社長：島村琢哉）は、半導体パッケージ用及び、製造工程でのサポート用のガラス基板を開発しました。

次世代の半導体やMEMSデバイスのパッケージとして、Wafer Level Package技術が目覚ましい進展を遂げており、そこへガラスウエハを応用するニーズが高まっています。シリコンウエハとガラスウエハを直接貼合する場合、双方の熱膨張係数(Coefficient of Thermal Expansion: CTE)の違いによる反りをなくすため、シリコンと完全にCTEが一致したガラスウエハが求められています。またFan Out Wafer Level Package(FOWLP)技術では、シリコンウエハ、再配線層や、樹脂等のCTEの異なる材料を同一ウエハ上で接合する工程があり、それぞれのデバイス毎に組み合わせやパターン形状が異なるため、それらに最適なCTEを持つガラス基板が求められます。更に、一般的なガラスに含まれるアルカリ成分は、製造プロセスやデバイスを汚染する恐れがあるため、アプリケーションによっては、無アルカリガラスが求められています。

今回開発したガラス基板では、以下のようなラインナップを取りそろえ、お客様の様々なニーズにお応えしてまいります。

- 無アルカリガラス
 - ◆ 常温から約 250℃までの範囲でCTEがシリコンと完全に一致したガラス
 - ◆ 3ppm/℃から 8ppm/℃まで、幅広いCTEに対応したガラス
- アルカリを含むガラス
 - ◆ 更に高いCTE12ppm/℃まで対応したガラス

幅広い熱膨張係数(CTE)のラインナップ



形状については通常の真円のウエハに加え、長方形や正方形のパネルにも対応が可能です。また基板厚みは0.2mmから、2mmまでを取りそろえております。

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC 旭硝子 経営企画部 広報・IR 室長 玉城 和美

(担当：鳥山 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com)

なお当社は、2017年1月18日(水)～20日(金)まで、東京ビッグサイトで開催される、ネプコンジャパン 2017 第18回 半導体パッケージング技術展の西ホール1階W3-6ブースにて、本製品の展示説明を行います。

AGCグループは、経営方針 **AGC plus** の下、世の中に、「安心・安全・快適」を、お客様に、「新たな価値・機能」を、プラスする製品づくりに取り組んでいます。長年培ってきたガラス技術を活かし、高付加価値の製品をグローバルに提供してまいります。

以上

<ご参考>

■展示会概要

1. イベント名 ネプコンジャパン 2017 第18回 半導体パッケージング技術展
2. 概 要 年に一回開催されるエレクトロニクス関連産業の展示会・イベント
3. 開 催 地 東京ビッグサイト (日本)
4. 会 期 2017年1月18日(水)～2017年1月20日(金)
5. 小間番号 西ホール1階 W3 - 6
5. URL <http://www.icp-expo.jp/>

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC 旭硝子 経営企画部 広報・IR 室長 玉城 和美

(担当：烏山 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com)